

2022-2028年中国半导体封装及测试设备产业发展现状与前景趋势报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2022-2028年中国半导体封装及测试设备产业发展现状与前景趋势报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202204/286455.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

尽管精测电子、长川科技、北京华峰测控、北京冠中集创、金海通等实现部分测试设备或分选机的国产化突破，但国产品牌主要聚焦在国内较为成熟的电源管理芯片测试设备等领域，而SOC和Memory芯片测试设备仍主要依赖于美国泰瑞达和日本爱德万等进口品牌。精测电子、长川科技、北京冠中集创等布局的数字测试设备急需市场培育。

硅片生长与加工设备：晶盛与晶能双双突破

半导体硅片项目众多，但绝大部分设备依赖进口，对日本设备厂商依赖程度高：

(1)

长晶炉

进口品牌韩国S-TECH，国产品牌晶盛机电、南京晶能，晶盛机电有望实现长晶炉国产化；

(2)

研磨设备

95%以上来自日本，包括设备厂商东京工程、光洋机械、东京精机、HAMAI等；晶盛机电有望实现国产化；

(3)

抛光

100%依赖进口，外资品牌包括Lapmaster、不二越、OKAMOTO、东京精机；

(4)

减薄

100%从日本进口，包括DISCO、光洋机械、OKAMOTO（冈本机械）。

根据2019年第二季最新营收统计，半导体封测业务公司主要集中在中国大陆和台湾，台湾日月光收购硅品后市占率高达37%，大陆企业长电、华天和通富总占比约25%。2019年Q2封测业受到中美贸易摩擦、手机销量下滑及存储器价格偏低等因素拖累，大多数封测厂商营收持续走跌，京元电和欣邦科技营收增长受益于面板市场超预期增长。2019年第三季度全球前十大封测厂商排名（百万美元）

排名	公司	2018Q3营收	2019Q3营收	2019Q3市占率	2019营收年增长率
1	日月光	1319	1321	22.0%	0.2%
2	安靠	1144	1084	18.1%	-5.2%
3	江苏长电	1002	1006	16.8%	0.4%
4	矽品	769	763	12.7%	-0.8%
5	力成	593	566	9.4%	-4.6%
6	通富微电	296	352	5.9%	18.9%
7	天水华天	262	324	5.4%	23.7%
8	京元电	179	225	3.8%	25.7%
9	联测	202	183	3.1%	-9.4%
10	颀邦	173	174	2.9%	0.6%

中企顾问网发布的《2022-2028年中国半导体封装及测试设备产业发展现状与前景趋势报告》共

十四章。首先介绍了中国半导体封装及测试设备行业市场发展环境、半导体封装及测试设备整体运行态势等，接着分析了中国半导体封装及测试设备行业市场运行的现状，然后介绍了半导体封装及测试设备市场竞争格局。随后，报告对半导体封装及测试设备做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国半导体封装及测试设备行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体封装及测试设备产业有个系统的了解或者想投资中国半导体封装及测试设备行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 半导体封装及测试设备行业发展综述

第一节 半导体封装及测试设备行业定义及分类

一、行业定义

二、行业主要产品分类

三、行业主要商业模式

第二节 半导体封装及测试设备行业特征分析

一、产业链分析

二、半导体封装及测试设备行业在国民经济中的地位

三、半导体封装及测试设备行业生命周期分析

1、行业生命周期理论基础

2、半导体封装及测试设备行业生命周期

第三节 半导体封装及测试设备行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒 / 退出机制

五、风险性

六、行业周期

七、竞争激烈程度指标

八、行业及其主要子行业成熟度分析

第二章 2015-2019年中国行业运行环境分析

第一节 半导体封装及测试设备行业政治法律环境分析

- 一、行业管理体制分析
- 二、行业主要法律法规
- 三、行业相关发展规划

第二节 半导体封装及测试设备行业经济环境分析

- 一、国际宏观经济形势分析
- 二、国内宏观经济形势分析
- 三、产业宏观经济环境分析

第三节 半导体封装及测试设备行业社会环境分析

- 一、半导体封装及测试设备产业社会环境
- 二、社会环境对行业的影响
- 三、半导体封装及测试设备产业发展对社会发展的影响

第四节 半导体封装及测试设备行业技术环境分析

- 一、半导体封装及测试设备技术分析
- 二、半导体封装及测试设备技术发展水平
- 三、行业主要技术发展趋势

第三章 2015-2019年中国半导体封装及测试设备所属行业运行分析

第一节 半导体封装及测试设备行业发展状况分析

- 一、半导体封装及测试设备行业发展阶段
- 二、半导体封装及测试设备行业发展总体概况

2017年底，作为5家刻蚀设备供应商之一，中微被TSMC纳入7nm制程设备采购名单，2018年底其自主研发的5nm等离子刻蚀机经TSMC验证通过。在台积电7nm制程继续扩产，以及5nm制程产线建设期间，中微的等离子刻蚀机台有望迎来旺盛需求，享受5G手机带来对先进制程工艺设备的爆发式需求增长。

测试设备：国产品牌开始迈向SOC和Memory测试市场

半导体测试细分为：SOC测试，RF测试、MemoryIC测试和AnalogIC测试。其中SOC测试占到ATE的64%，MemoryIC和RF测试设备各占15-20%。2018年全球半导体测试设备市场规模约为55-60亿美元，按64%的比例推算，SOC测试设备市场规模估计为36亿美元。SOC测试占半导体测试设备的2/3

三、半导体封装及测试设备行业发展特点分

第二节 半导体封装及测试设备行业发展现状

一、半导体封装及测试设备行业市场规模

二、半导体封装及测试设备行业发展分析

三、半导体封装及测试设备企业发展分析

第三节 区域市场分析

一、区域市场分布总体情况

二、重点省市市场分析

第四节 半导体封装及测试设备细分产品/服务市场分析

一、细分产品/服务特色

二、细分产品/服务市场规模及增速

三、重点细分产品/服务市场前景预测

第五节 半导体封装及测试设备产品/服务价格分析

一、半导体封装及测试设备价格走势

二、影响半导体封装及测试设备价格的关键因素分析

1、成本

2、供需情况

3、关联产品

4、其他

三、2022-2028年半导体封装及测试设备产品/服务价格变化趋势

四、主要半导体封装及测试设备企业价位及价格策略

第四章 2015-2019年中国半导体封装及测试设备所属行业整体运行指标分析

第一节 半导体封装及测试设备所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、人员规模状况分析

三、行业资产规模分析

四、行业市场规模分析

第二节 半导体封装及测试设备所属行业产销情况分析

一、半导体封装及测试设备行业工业总产值

二、半导体封装及测试设备行业工业销售产值

三、半导体封装及测试设备行业产销率

第三节 半导体封装及测试设备所属行业财务指标总体分析

- 一、行业盈利能力分析
- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第五章 2015-2019年中国半导体封装及测试设备所属行业供需形势分析

第一节 半导体封装及测试设备行业供给分析

- 一、半导体封装及测试设备行业供给分析
- 二、2022-2028年半导体封装及测试设备行业供给变化趋势
- 三、半导体封装及测试设备行业区域供给分析

第二节 半导体封装及测试设备行业需求情况

- 一、半导体封装及测试设备行业需求市场
- 二、半导体封装及测试设备行业客户结构
- 三、半导体封装及测试设备行业需求的地区差异

第三节 半导体封装及测试设备市场应用及需求预测

- 一、半导体封装及测试设备应用市场总体需求分析
 - 1、半导体封装及测试设备应用市场需求特征
 - 2、半导体封装及测试设备应用市场需求总规模
- 二、2022-2028年半导体封装及测试设备行业领域需求量预测
 - 1、2022-2028年半导体封装及测试设备行业领域需求产品/服务功能预测
 - 2、2022-2028年半导体封装及测试设备行业领域需求产品/服务市场格局预测
- 三、重点行业半导体封装及测试设备产品/服务需求分析预测

第六章 2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业产业结构分析

第一节 半导体封装及测试设备产业结构分析

- 一、市场细分充分程度分析
- 二、各细分市场领先企业排名
- 三、各细分市场占总市场的结构比例
- 四、领先企业的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

- 一、产业价值链的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第三节 产业结构发展预测

一、产业结构调整指导政策分析

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素

三、中国半导体封装及测试设备行业参与国际竞争的战略市场定位

四、产业结构调整方向分析

第七章 2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业产业链分析

第一节 半导体封装及测试设备行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

第二节 半导体封装及测试设备上游行业分析

一、半导体封装及测试设备产品成本构成

二、上游行业发展现状

三、2022-2028年上游行业发展趋势

四、上游供给对半导体封装及测试设备行业的影响

第三节 半导体封装及测试设备下游行业分析

一、半导体封装及测试设备下游行业分布

二、下游行业发展现状

三、2022-2028年下游行业发展趋势

四、下游需求对半导体封装及测试设备行业的影响

第八章 2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业渠道分析及策略

第一节 半导体封装及测试设备行业渠道分析

一、渠道形式及对比

二、各类渠道对半导体封装及测试设备行业的影响

三、主要半导体封装及测试设备企业渠道策略研究

四、各区域主要代理商情况

第二节 半导体封装及测试设备行业用户分析

一、用户认知程度分析

二、用户需求特点分析

三、用户购买途径分析

第三节 半导体封装及测试设备行业营销策略分析

- 一、中国半导体封装及测试设备营销概况
- 二、半导体封装及测试设备营销策略探讨
- 三、半导体封装及测试设备营销发展趋势

第九章 2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业竞争形势及策略

第一节 行业总体市场竞争状况分析

- 一、半导体封装及测试设备行业竞争结构分析
 - 1、现有企业间竞争
 - 2、潜在进入者分析
 - 3、替代品威胁分析
 - 4、供应商议价能力
 - 5、客户议价能力
 - 6、竞争结构特点总结
- 二、半导体封装及测试设备行业企业间竞争格局分析
- 三、半导体封装及测试设备行业集中度分析
- 四、半导体封装及测试设备行业SWOT分析

第二节 半导体封装及测试设备行业竞争格局综述

- 一、半导体封装及测试设备行业竞争概况
 - 1、中国半导体封装及测试设备行业竞争格局
 - 2、半导体封装及测试设备行业未来竞争格局和特点
 - 3、半导体封装及测试设备市场进入及竞争对手分析
- 二、中国半导体封装及测试设备行业竞争力分析
 - 1、中国半导体封装及测试设备行业竞争力剖析
 - 2、中国半导体封装及测试设备企业市场竞争的优势
 - 3、国内半导体封装及测试设备企业竞争能力提升途径
- 三、半导体封装及测试设备市场竞争策略分析

第十章 中国半导体封装及测试设备主要企业发展概述

第一节 泛林集团

- 一、企业概况

- 二、企业优势分析
- 三、产品/服务特色
- 四、经营状况
- 五、发展规划

第二节 阿斯麦

- 一、企业概况
- 二、企业优势分析
- 三、产品/服务特色
- 四、经营状况
- 五、发展规划

第三节 东京电子

- 一、企业概况
- 二、企业优势分析
- 三、产品/服务特色
- 四、经营状况
- 五、发展规划

第四节 其他

- 一、企业概况
- 二、企业优势分析
- 三、产品/服务特色
- 四、经营状况
- 五、发展规划

第十一章 2022-2028年中国半导体封装及测试设备行业投资前景分析

第一节 半导体封装及测试设备市场发展前景

- 一、半导体封装及测试设备市场发展潜力
- 二、半导体封装及测试设备市场发展前景展望
- 三、半导体封装及测试设备细分行业发展前景分析

第二节 半导体封装及测试设备市场发展趋势预测

- 一、半导体封装及测试设备行业发展趋势
- 二、半导体封装及测试设备市场规模预测
- 三、半导体封装及测试设备行业应用趋势预测

四、2022-2028年细分市场发展趋势预测

第三节 半导体封装及测试设备行业供需预测

一、半导体封装及测试设备行业供给预测

二、半导体封装及测试设备行业需求预测

三、半导体封装及测试设备供需平衡预测

第四节 影响企业生产与经营的关键趋势

一、市场整合成长趋势

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测

三、企业区域市场拓展的趋势

四、科研开发趋势及替代技术进展

五、影响企业销售与服务方式的关键趋势

第十二章 2022-2028年中国半导体封装及测试设备行业投资机会与风险分析

第一节 半导体封装及测试设备行业投融资情况

一、行业资金渠道分析

二、固定资产投资分析

三、兼并重组情况分析

第二节 半导体封装及测试设备行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

第三节 半导体封装及测试设备行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

第十三章 2022-2028年中国半导体封装及测试设备行业投资战略研究（一）

第一节 半导体封装及测试设备行业发展战略研究

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划

第二节 半导体封装及测试设备新产品差异化战略

- 一、半导体封装及测试设备行业投资战略研究
- 二、半导体封装及测试设备行业投资战略
- 三、半导体封装及测试设备行业投资战略
- 四、细分行业投资战略

第十四章 研究结论及投资建议（）

第一节 半导体封装及测试设备行业研究结论

第二节 半导体封装及测试设备行业投资价值评估

第三节 半导体封装及测试设备行业投资建议

- 一、行业发展策略建议
- 二、行业投资方向建议
- 三、行业投资方式建议

图表目录：

图表：半导体封装及测试设备行业生命周期

图表：半导体封装及测试设备行业产业链结构

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业市场规模

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备市场占全球份额比较

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业重要数据指标比较

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业集中度

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业销售收入

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业利润总额

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业资产总计

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业负债总计

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备市场价格走势

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业竞争力分析

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业工业总产值

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业主营业务收入

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业主营业务成本

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业销售费用分析

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业管理费用分析

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业财务费用分析

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业销售毛利率分析

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业销售利润率分析

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业成本费用利润率分析

图表：2015-2019年中国半导体封装及测试设备行业总资产利润率分析

更多图表请见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202204/286455.html>